

[별첨 112-3]

생산시설 세부설명

□ 생산설비

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	작업대	구입된 부품의 검사와 조립 등 생산 작업을 할 수 있는 작업대
2	작업공구	전동드라이버 등
3	<삭제>	<삭제>
4	HDD COPY 장비	안정적으로 Operation System 대량설치 장비(단일 또는 합계 8포트 이상)
5	<삭제>	<삭제>
4	에이징 설비	제품 테스트 설비

□ 검사설비

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	전력·소비전력자동측정기록계	소비전력 및 대기전력 측정기
2	입력전압안정화기기	AC전원 일정공급 장치
3	<삭제>	<삭제>
4	<삭제>	<삭제>
5	<삭제>	<삭제>
6	<삭제>	<삭제>
3	안전규격장비 (내압·절연저항)	순간전기충격 측정 검사

[별첨 112-4]

생산공정 세부설명

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	원부자재 구입(외주가능)	국내 제조 또는 수입된 원부자재(파워, 메인보드, 그래픽카드, 사운드카드, 랜카드 등)를 구입
2	자재검사	구입된 원부자재의 품질을 검사
3	조립 등 생산	구입 또는 자체제작한 원부자재를 조립
4	공정검사(Q.C)	조립 공정 중에 품질 검사
5	최종검사	조립 완료 후에 최종 품질 검사
6	포장	최종검사가 완료 된 제품을 출고 할 수 있게 포장
7	출하	포장 된 제품을 출하